

广东喜珍电路科技有限公司等三家单位完成的“超级拼版多层印制电路板的研制”通过我会科技成果评价，该项目成果关键技术达到国内领先水平，其中排版尺寸达到国际先进水平！

2022年7月25日，广东省电子学会在肇庆市召开了由广东喜珍电路科技有限公司、肇庆学院和奥士康科技股份有限公司共同完成的“超级拼版多层印制电路板的研制”科技成果评价会。



评价专家委员会由华南理工大学、广东省电路板行业协会、广东捷成科创电子股份有限公司、广东华锋新能源科技股份有限公司等专家组成。



项目针对超级拼版多层印制电路板制作过程中薄芯板容易损伤、钻孔精度、涨缩及均匀性控制难等问题，研制了包括半固化片的冲孔、铆合、叠层三个工序整合的工艺，采用 AGV 小车+6 轴机械手减少物料搬运，实现了生产自动化；建立了薄芯板控制及蚀刻、镀铜、压板均匀性和钻孔精度等关键技术问题。

该项目成果获得授权专利 11 件，其中发明专利 8 件，实用新型专利 3 件；制定并发布团体标准 1 项。项目成果已实现产业化，相对传统尺寸产品，水电单耗降低 25%、板材耗用降低了 5%，生产效率提高了 51%。经用户使用反馈良好，取得了良好的经济和社会效益。

专家委员会认为该成果关键技术达到了国内领先水平，其中排版尺寸达到国际先进水平。